

WAIE 2021

2021 3rd International Workshop on Artificial Intelligence and Education

Xi'an, China | November 19-21, 2021

WAIE 2021 is sponsored by Xidian University(China), hosted by School of Telecommunications Engineering, Xidian University, supported by Université de Montréal, Canada, Okayama University, Japan, etc.

WAIE aims to provide a platform for scholars, engineers, and scientists to present robust research demonstrating the expanding frontiers in the fields of Artificial Intelligence and Education.



IMPORTANT DATE

- **Submission Deadline: July 15, 2021**
- Notification Date: August 05, 2021
- Registration Deadline: August 20, 2021
- Conference Date: November 19-21, 2021

CALL FOR PAPERS

- Data Mining and Machine Learning
- Semantic Web Technologies
- Multi-agent Architectures
- Tangible interfaces, wearables and augmented reality
- Modelling and Representation
- Ontological Modelling
- Computational Thinking and Model-building
- Models of Teaching and Learning
- Learning Contexts and Informal Learning
- Design and formative studies of AIED system
- Intelligent Tutoring and Scaffolding
- Motivational diagnosis and feedback
- Domain-specific Learning Applications
- Collaborative and group learning

More topics: <http://www.waie.org/topic.html>

Accepted and selected papers will be recommended to be published in the **WAIE Conference Proceedings Series**, which could be submitted for **Ei Compindex** and **Scopus** Index.

CONTACT INFORMATION

- Ms. Ching Cao
- Tel: 86-28-83207566
- Email: waie_conf@126.com
- Web: www.waie.org



Wechat Contact

PUBLICATION & INDEXING

SUBMISSION METHOD

- **Electronic Submission System** (Click)
- **Submission via E-mail:** waie_conf@126.com

Submission Type

Full Paper (Publication & Oral Presentation) / Abstract (Oral Presentation only). Please prepare your paper according to the paper template. The full paper should be at least 5 pages in length.

DOCUMENTS DOWNLOAD

- **Paper Template Download** (Click)
- **Register as a Listener now!** (Click)

Sponsored by



Hosted by



通信工程学院
School of Telecommunications Engineering

Technically Sponsored by



WAIE 2021

2021年第三届人工智能与教育国际研讨会

中国 西安 | 11月19-21日

WAIE 2021由本次会议由西安电子科技大学主办，西安电子科技大学通信工程学院承办，也受到了加拿大蒙特利尔大学，日本冈山大学等学术单位以及机构的支持。该会议已于2019年在新加坡召开，2020年因新冠疫情影响启用网络平台Zoom成功召开。

会议定位为人工智能与教育应用技术及产业化发展交流探讨，面向智能技术企业和科研院所研发人员，工程师，市场开拓者和行业组织，涉及内容为人工智能与教育发展趋势，应用模式，商业模式，创业经验等。



重要日期

- 投稿截止日: 2021年07月15日
- 录用通知日: 2021年8月5日
- 注册截止日: 2021年8月20日
- 会议日期: 2021年11月19-21日

征稿主题

- 在教育环境中的智能和交互技术
- 数据挖掘和机器学习
- 语义Web技术
- 多代理体系结构
- 有形界面、可穿戴设备和增强现实
- 造型和代表性
- 本体建模
- 模仿动机、元认知和学习的情感方面
- 计算思维和模型构建
- 教学模式
- 协作和小组学习
- AIED系统的设计与形成研究
- 智能辅导与脚手架
- 特定领域的学习应用

更多主题: <http://www.waie.org/topic.html>

联系方式

- 曹女士
- Tel: 86-28-83207566
- Email: waie_conf@126.com
- Web: www.waie.org



微信服务号

请添加会议秘书微信二维码方便及时沟通。

出版 & 检索

录用的论文在会议上汇报后，将被推荐发表在WAIE 2021会议论文集，并被Ei Compendex和Scopus索引收录。

SUBMISSION METHOD

- 电子投稿系统 (Click)
- 邮箱投稿: waie_conf@126.com

投稿类型

全文: 口头报告+发表; 摘要: 仅口头报告。
请严格按照会议要求的模板格式化您的文章，全文投稿不低于5页内容。

DOCUMENTS DOWNLOAD

- 论文模板 (Click)
- 听众注册 (Click)

承办



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

主办



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

通信工程学院
School of Telecommunications Engineering

技术支持



岡山大学
OKAYAMA UNIVERSITY

